

APRUEBA CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (ITENE).

SANTIAGO, 007254 21.11.18.

VISTOS: El DFL. N° 149 de 1981, del Ministerio de Educación, y la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

La importancia para la Universidad de Santiago de Chile de promover la cooperación académica e interinstitucional e internacional y fomentar las relaciones bilaterales de carácter académico.

RESUELVO:

APRUEBESE el convenio, suscrito entre la Universidad de Santiago de Chile y el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y logística (ITENE), España, con fecha 24 de Agosto de 2018 y cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TRAVÉS DE SU FACULTAD TECNOLÓGICA (CHILE).

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y logística, en adelante ITENE, con domicilio legal en Parque Tecnológico c/ Albert Einstein, 1. 46980 Paterna Valencia, España representada por su Director Gerente y la **Universidad de Santiago de Chile**, en adelante UdeSantiago de Chile, a través de su Facultad Tecnológica con domicilio legal en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 3363, Santiago de Chile, Rut N° 60.911.000-7 representada por su Decano, Julio González Candía, acuerdan en celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: Los objetivos de este Convenio son, en general, promover el desarrollo y difusión de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica entre el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y logística (ITENE) y la Facultad Tecnológica de la UdeSantiago de Chile.

SEGUNDO: Para dar cumplimiento a los objetivos indicados, ambas partes, de común acuerdo, elaborarán programas y proyectos de cooperación, en los que se especificarán las obligaciones que asumirá cada una de ellas en la ejecución de los mismos.

TERCERO: Los programas y proyectos referidos en el artículo anterior serán objeto de acuerdos de ejecución entre ambas Instituciones, previa autorización de las autoridades centrales en cuanto ésta fuere necesaria según las reglamentaciones de cada parte.

CUARTO: Los programas antedichos serán elaborados y presentados a las autoridades correspondientes a través de los organismos técnicos dependientes de ambas Instituciones. En la Universidad de Santiago de Chile la unidad encargada será el Departamento de Relaciones Interuniversitarias e Internacionales, y en ITENE, la unidad encargada será Área Técnica.

QUINTO: Los acuerdos de ejecución se podrán referir, entre otros, a los siguientes aspectos:

- a) Intercambio, formación y perfeccionamiento de docentes, investigadores y personal; en temas que permitan desarrollar capacidades en envases y embalajes;
- b) Desarrollo de proyectos conjuntos para soluciones de I+D+I en áreas de envases y embalajes;
- c) Dictar cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc.;
- d) Asesorías a potenciales empresas interesadas en desarrollos realizados por la UdeSantiago de Chile e ITENE en el área de envases y embalajes;
- e) Desarrollo de tecnologías y soluciones de manera conjunta;
- f) Apoyo en la transferencia de las tecnologías y soluciones desarrolladas a la industria.

SEXTO: La propiedad intelectual que derive de los proyectos y trabajos realizados en conjunto, bajo el marco de este convenio, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los convenios específicos que firmarán las partes, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos proyectos y actividades.

Las partes convienen que podrán utilizar en sus funciones académicas la información y resultados derivados de las actividades realizadas en el presente instrumento, tomando las medidas necesarias para la adecuada protección de eventuales patentes, secretos y otros activos de propiedad intelectual que correspondan.

SÉPTIMO: Las personas relacionadas con este Convenio quedarán sometidas a las normas vigentes en la Institución en donde desenvuelven sus actividades, sin que adquieran, bajo ninguna circunstancia, vínculo laboral con la Institución Receptora. La selección de personas para trasladarse, por cualquier concepto, de una a otra Institución, se realizará según las normas de la Institución de origen, sin perjuicio de su aceptación por la Institución de destino.

OCTAVO: La puesta en funcionamiento de las disposiciones de este acuerdo será objeto de una programación anual o plurianual elaborada de común acuerdo por ambas Instituciones, que se consultarán mutuamente cada vez que lo crean necesario. La propuesta de programación corresponderá a una comisión mixta de seguimiento formada por la autoridad de cada institución o por las personas en quienes deleguen.

NOVENO: Sin perjuicio de los recursos que asigne cada Institución ambas partes se comprometen a realizar las gestiones pertinentes ante las respectivas Instituciones oficiales, como los Ministerios de Relaciones Exteriores de cada país, Consejos de Investigaciones Científicas y Técnicas, y similares; organismos internacionales, fundaciones, organizaciones de bien público o asociaciones privadas, con el fin de asegurar el desarrollo de las actividades a realizar entre las partes.

DÉCIMO: Este convenio tendrá vigencia durante un período de 5 años a partir de la fecha de la última firma. Este acuerdo podrá ser desahuciado antes de cumplido el plazo por iniciativa de cualquiera de las partes por medio de un aviso escrito presentado a la otra parte con, al menos, (3) meses de anticipación. Dicho desahucio no afectará los programas y proyectos en curso de ejecución.

DÉCIMO PRIMERO: Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este convenio se solucionará por negociación directa entre las partes. En cualquier momento una parte podrá proponer a la otra su modificación.

DÉCIMO SEGUNDO: A cuyo efecto se extenderán cuatro ejemplares.

La representación del D. Javier Zabaleta Meri con NIF 22.689.010-Q, actuando en nombre y representación del INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, en adelante ITENE, con domicilio social en C/ Albert Einstein, 1, 46980 Paterna (Valencia), con CIF número G-96308184, en uso del poder otorgado a su favor con fecha 14 de Diciembre de 2005, ante el Notario de Valencia D. José Manuel Valiente Fabrega, con el n° 1879/05 de su protocolo.

La representación del Dr. Julio González Candia, Decano de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, consta en el DECRETO TRA N° 323/2278/2017, que lo nombra Decano, y la delegación de facultades que lo autorizan para firmar en su calidad de decano consta en el Decreto Universitario N° 668 de 1988.

DR. JULIO GONZÁLEZ CANDIA
DECANO
FACULTAD TECNOLÓGICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

D. JAVIER ZABALETA MERI
DIRECTOR GERENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE,
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (ITENE).

Fecha: 24/8/2018

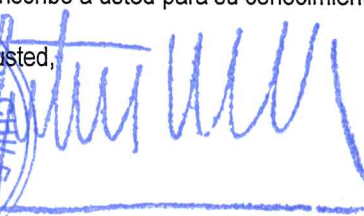
Fecha: 02 JULIO 2018

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,

Dr. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, Rector

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

Saluda a usted,


GUSTAVO ROBLES LABARCA
SECRETARIO GENERAL

JMZ/AB/GDLB
IP: 80045

DISTRIBUCIÓN:
1 Rectoría
1 Contraloría Universitaria
1 Dirección de Relaciones Interuniversitarias e Internacionales
1 Oficina de Partes
1 Archivo Central